

JapariMeter Rev.1 組み立てマニュアル

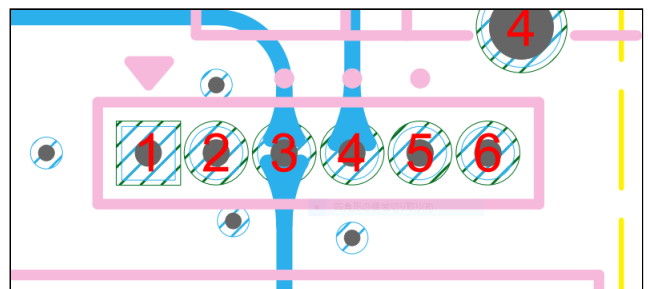
エラッタ

- 積層セラミックコンデンサ C1, C2 を実装するとプログラムの書き換えができなくなるため、実装前にプログラムは書き込むこと。

実装の注意

- BME280 との接続ランドがはんだ付けしづらい。場合によっては接触不良になるため、ピンヘッドなどでスルーホールを貫通させつつはんだを流し込み、本体基板と BME280 が確実に接触した後にピンヘッドを外す。
- 電池ボックスのマイナス極が接触のため、0.5mm 程度はんだを盛ること。
- タクトスイッチ SW1, SW2 は前傾に注意すること。
- プログラム書き込みは ICSP パッドを介して行う。書き込みプロトコルは ST-LINK/V2。ケーブルは [ピンヘッド付き6極ケーブル](#) を使う。

1. VDD 3.3V (▼印)
2. reserved
3. SWDIO (●印)
4. RESET (●印)
5. SWCLK (●印)
6. GND



実装手順

1. 表面実装部品 **C3, C4, R1, R2, R3, R4** を実装
2. MCU **U1** を実装
3. ICSPパッドよりプログラム書き込み
4. 積層セラミックコンデンサ **C1, C2** を実装
5. センサ基板 **U2** を実装
6. 面付け基板切り離し、側面処理
7. スライドスイッチ **SW3** を実装
8. タクトスイッチ **SW1, SW2** を実装
9. OLEDディスプレイ **U3** を実装
10. 電解コンデンサ **C5** を実装
11. 電池ボックス **B1** を背面に実装
12. スペーサ取り付け
13. アクリルパネル取り付け